

## 求人情報

企業コード:e0215 ジョブコード:20240216-189-01-012

マネージャーレベル

ポジション名	【先端プロセス開発エンジニア】公的研究機関との共同開発！
この求人情報の取扱い会社	株式会社 リクルート（リクルートエージェント / Recruit Agent）
企業名	ヤマハロボティクスホールディングス(株)
掲載開始・更新	2024-05-11 / 2024-05-14
職種	機械（自動車/プラント/精密機器） - プログラマー(制御系)
業種	半導体・電気・電子部品メーカー
勤務地	アジア 日本 茨城県
仕事内容	<p>■大学や研究所の研究員と共に、次世代ダイレクトボンディング研究開発（プロセス開発）を行います。</p> <p>■採用背景：次世代接合技術であるダイレクトボンディングの実用化を目指し、2021年9月より外部研究所との共同開発を実施しております。当ポジションでは、研究開発を通じて新技術への知見とスキルを身に付けていただき、当社の開発の加速と、新技術の継続的な発展を進めていく事に貢献していただくことを期待します。</p> <p>★理工系の基礎知識と、新技術に挑戦するモチベーションを重視した採用です</p>
企業について(社風など)	グループ会社の経営戦略策定及び経営管理 従業員数 47名
応募条件	<p>【いずれも必須】 ■半導体に関わる何かしらの開発経験 ■理工系学卒の方（機械、電気、材料、物理） ■英文での技術資料作成スキル</p> <p>ヤマハロボティクスホールディングスではグループ全体の事業戦略である“1 STOP SMART SOLUTION”の推進と共に、半導体製造装置の付加価値向上に向けて応用開発を行っています。</p> <p>近年の急速なAI技術の活用において半導体は競争力の源泉となっており、最先端の画像認識技術やプロセス技術の研究開発を行うことで未来のAI社会を支えるための技術開発に取り組んでいます。</p>
英語能力	ビジネス会話 (TOEIC 735-860)
日本語能力	流暢（日本語能力試験1級又はN1）
年収	日本・円 400万円～800万円
休日	年間休日 121日
契約期間	正社員